

<b>Title of Change:</b>	D2PAK Case Outline Standardization from 418B-04 to 418AJ for all effected devices manufactured in On Semiconductor Seremban, On Semiconductor Vietnam and TFME facility.
<b>Effective date:</b>	14 July 2019
<b>Contact information:</b>	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <Norsahida.sahman@onsemi.com>
<b>Type of notification:</b>	This Product Bulletin is for notification purposes only. ON Semiconductor will proceed with implementation of this change upon publication of this Product Bulletin.
<b>Change Category:</b>	<input type="checkbox"/> Wafer Fab <input type="checkbox"/> Assembly Change <input type="checkbox"/> Test Change <input checked="" type="checkbox"/> Other <u>Case Outline</u>

**Change Sub-Category(s):**

<input type="checkbox"/> Manufacturing Site Addition	<input type="checkbox"/> Material Change	<input checked="" type="checkbox"/> Datasheet/Product Doc change
<input type="checkbox"/> Manufacturing Site Transfer	<input type="checkbox"/> Product specific change	<input type="checkbox"/> Shipping/Packaging/Marking
<input type="checkbox"/> Manufacturing Process Change		<input type="checkbox"/> Other: _____

<b>Sites Affected:</b>	ON Semiconductor Sites: ON Seremban, Malaysia ON Dong Nai Province, Vietnam	External Foundry/Subcon Sites: TFME
------------------------	---	--

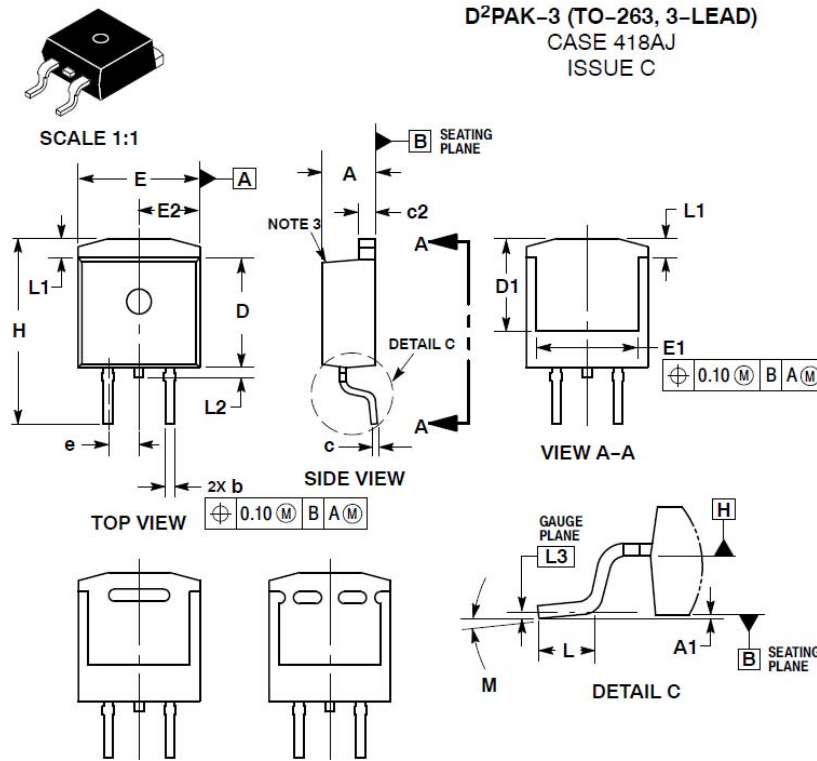
**Description and Purpose:**

ON Semiconductor is migrating the D2PAK discrete package case outline from version 418B-04 to version 418AJ. The change impacts the Rectifier, BJT and MOSFET product lines. This transition allows ON Semiconductor to standardize its significantly increased portfolio on a single case outline.

This notification does not represent a change to existing materials, tools or processes used to manufacture the affected devices. The new case outline, 418AJ, is consistent with JEDEC dimensional guidelines for the D2PAK.

**D<sup>2</sup>PAK-3 (TO-263, 3-LEAD)**  
 CASE 418AJ  
 ISSUE C

DATE 03 OCT 2018



**NOTES:**

- DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ASME Y14.5M, 1994.
- CONTROLLING DIMENSION: INCHES.
- CHAMFER OPTIONAL
- DIMENSIONS D AND E DO NOT INCLUDE MOLD FLASH. MOLD FLASH SHALL NOT EXCEED 0.005 PER SIDE. THESE DIMENSIONS ARE MEASURED AT THE OUTERMOST EXTREMES OF THE PLASTIC BODY AT DATUM H.
- THERMAL PAD CONTOUR IS OPTIONAL WITHIN DIMENSIONS E, L1, D1 AND E1.

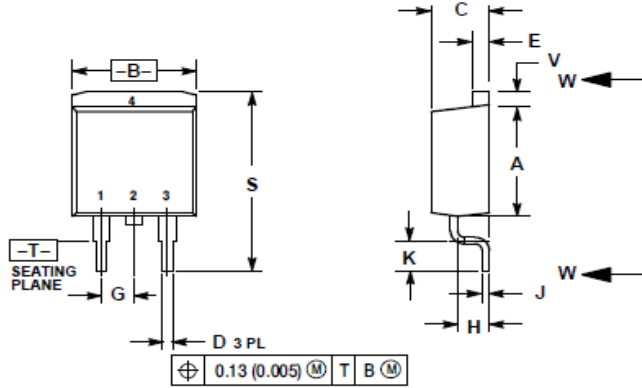
DIM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.160	0.190	4.06	4.83
A1	0.000	0.010	0.00	0.25
b	0.020	0.039	0.51	0.99
c	0.012	0.029	0.30	0.74
c2	0.045	0.065	1.14	1.65
D	0.330	0.380	8.38	9.65
D1	0.260	----	6.60	----
E	0.380	0.420	9.65	10.67
E1	0.245	----	6.22	----
e	0.100 BSC	----	2.54 BSC	----
H	0.575	0.625	14.60	15.88
L	0.070	0.110	1.78	2.79
L1	----	0.066	----	1.68
L2	----	0.070	----	1.78
L3	0.010 BSC	----	0.25 BSC	----
M	-8°	8°	-8°	8°



**D<sup>2</sup>PAK 3**  
CASE 418B-04  
ISSUE L

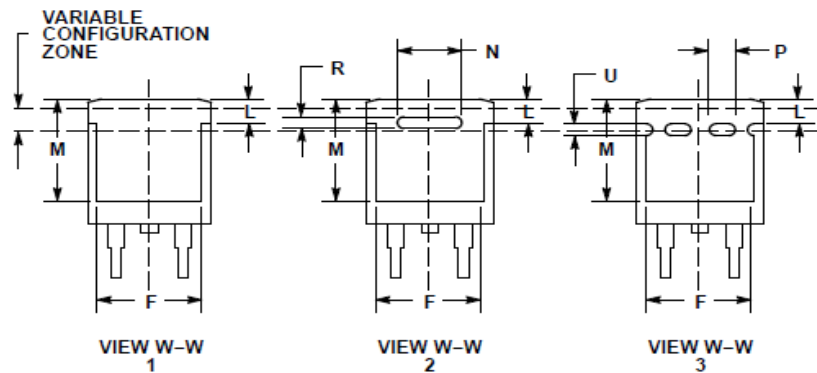
DATE 17 FEB 2015

SCALE 1:1



- NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI Y14.5M, 1982.
  2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.
  3. 418B-01 THRU 418B-03 OBSOLETE. NEW STANDARD 418B-04.

DIM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.340	0.380	8.64	9.65
B	0.380	0.405	9.65	10.29
C	0.160	0.190	4.06	4.83
D	0.020	0.035	0.51	0.89
E	0.045	0.055	1.14	1.40
F	0.310	0.350	7.87	8.89
G	0.100 BSC		2.54 BSC	
H	0.080	0.110	2.03	2.79
J	0.018	0.025	0.46	0.64
K	0.090	0.110	2.29	2.79
L	0.052	0.072	1.32	1.83
M	0.280	0.320	7.11	8.13
N	0.197 REF		5.00 REF	
P	0.079 REF		2.00 REF	
R	0.039 REF		0.99 REF	
S	0.575	0.625	14.60	15.88
V	0.045	0.055	1.14	1.40



**List of Affected Parts:**

BUB323ZG	MBRB2515LT4G	MBRB60H100CTT4G	MURB1660CTG	NTB5605PT4G	NTSB30U100CTG
BUB323ZT4G	MBRB2515LT4H	MBRB8H100T4G	MURB1660CTT4G	NTB60N06T4	NTSB30U100CTT4G
MBRB1045G	MBRB2535CTLG	MJB41CG	MURHB840CTG	NTB60N06T4G	NTSB40100CTG
MBRB1045T4G	MBRB2535CTLT4G	MJB41CT4G	MURHB840CTT4G	NTB6410ANT4G	NTSB40100CTT4G
MBRB1545CTG	MBRB2545CTG	MJB42CT4G	MURHB860CTT4G	NTB6413ANT4G	NTSB40120CTG
MBRB1545CTT4G	MBRB2545CTT4G	MJB44H11G	NGB8202ANT4G	NTSB20100CTG	NTSB40120CTT4G
MBRB1645T4G	MBRB3030CTG	MJB44H11T4G	NGB8206ANSL3G	NTSB20100CTT4G	NTSB40200CTG
MBRB20100CTG	MBRB3030CTLG	MJB45H11G	NGB8206ANT4G	NTSB20120CTG	NTSB40200CTT4G
MBRB20100CTT4G	MBRB3030CTT4G	MJB45H11T4G	NGB8206ANTF4G	NTSB20120CTT4G	NTSB60100CTG
MBRB20200CTG	MBRB30H60CTT4G	MJB5742T4G	NTB25P06T4G	NTSB20U100CTG	NTSB60100CTT4G
MBRB20200CTT4G	MBRB40250TG	MTB50P03HDLT4G	NTB35N15T4G	NTSB20U100CTT4G	XMBRB1045T4G
MBRB2060CTG	MBRB40250TT4G	MURB1620CTG	NTB45N06LT4G		NTSB30100CTG
MBRB2060CTT4G	MBRB4030G	MURB1620CTRG	NTB45N06T4G		NTSB30100CTT4G
MBRB20H100CTT4G	MBRB4030T4G	MURB1620CTRT4G	NTB52N10T4		NTSB30120CTG
MBRB2515LG	MBRB41H100CTT4G	MURB1620CTT4G	NTB5405NT4G		NTSB30120CTT4G

Japanese translation of the notification starts here.  
通知の日本語訳はここから始まります。

*Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。

変更件名:	オン・セミコンダクター セレンバン、オン・セミコンダクター ベトナム、および TFME 工場で製造されるすべての対象製品の D2PAK ケースアウトラインを、418B-04 から 418AJ に標準化。
発効日:	14 July 2019
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <Norsahida.sahman@onsemi.com> にお問い合わせください。
通知種別:	本製品速報は通知目的のみです。オン・セミコンダクターは本製品速報の発行により本変更を実行します。
変更カテゴリ:	<input type="checkbox"/> ウェハファブの変更 <input type="checkbox"/> アセンブリの変更 <input type="checkbox"/> 試験の変更 <input checked="" type="checkbox"/> その他 <u>ケース外形</u>

変更サブカテゴリ:	<input type="checkbox"/> 製造拠点の追加 <input type="checkbox"/> 材料の変更 <input checked="" type="checkbox"/> データシート/製品資料の変更 <input type="checkbox"/> 製造拠点の移転 <input type="checkbox"/> 製品仕様の変更 <input type="checkbox"/> 出荷/パッケージング/表記 <input type="checkbox"/> 製造プロセスの変更 <input type="checkbox"/> その他: _____
-----------	--

影響を受ける拠点:	オン・セミコンダクター拠点: オン セレンバン (マレーシア) オン ドンナイ省 (ベトナム)	外部製造工場 / 下請け業者拠点: TFME
-----------	---	---------------------------

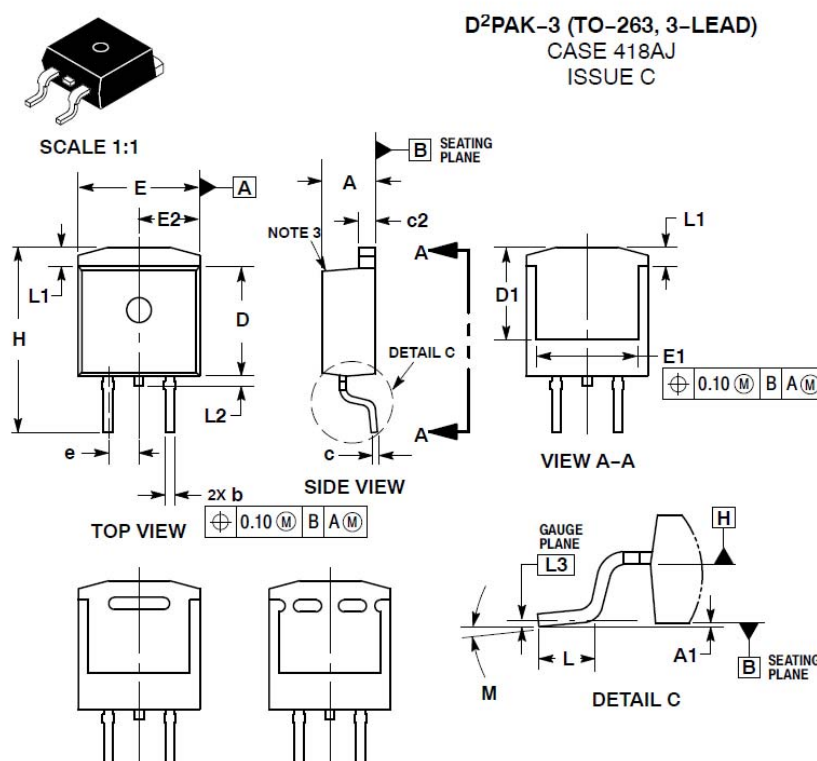
説明および目的:

オン・セミコンダクターは、D2PAK ディスクリートパッケージのケースアウトラインを、バージョン 418B-04 からバージョン 418AJ に移行します。この変更は、整流器、BJT、および MOSFET 製造ラインに影響を与えます。この移行により、オン・セミコンダクターは統一されたケースアウトラインに基づいて、大幅に増大したポートフォリオを標準化できます。

この通知は、対象製品の製造に使用される既存の材料、ツール、またはプロセスへの変更を意味するものではありません。新しいケースアウトラインの 418AJ は、D2PAK の JEDEC 寸法ガイドラインに適合しています。

**D2PAK-3 (TO-263, 3-LEAD)**  
 CASE 418AJ  
 ISSUE C

DATE 03 OCT 2018



SCALE 1:1

NOTES:

- DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ASME Y14.5M, 1994.
- CONTROLLING DIMENSION: INCHES.
- CHAMFER OPTIONAL
- DIMENSIONS D AND E DO NOT INCLUDE MOLD FLASH. MOLD FLASH SHALL NOT EXCEED 0.005 PER SIDE. THESE DIMENSIONS ARE MEASURED AT THE OUTERMOST EXTREMES OF THE PLASTIC BODY AT DATUM H.
- THERMAL PAD CONTOUR IS OPTIONAL WITHIN DIMENSIONS E, L1, D1 AND E1.

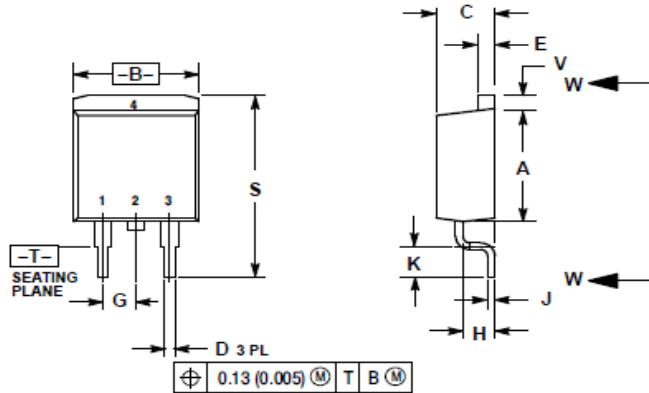
DIM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.160	0.190	4.06	4.83
A1	0.000	0.010	0.00	0.25
b	0.020	0.039	0.51	0.99
c	0.012	0.029	0.30	0.74
c2	0.045	0.065	1.14	1.65
D	0.330	0.380	8.38	9.65
D1	0.260	----	6.60	----
E	0.380	0.420	9.65	10.67
E1	0.245	----	6.22	----
e	0.100	BSC	2.54	BSC
H	0.575	0.625	14.60	15.88
L	0.070	0.110	1.78	2.79
L1	----	0.066	----	1.68
L2	----	0.070	----	1.78
L3	0.010	BSC	0.25	BSC
M	-8°	8°	-8°	8°



SCALE 1:1

D<sup>2</sup>PAK 3  
CASE 418B-04  
ISSUE L

DATE 17 FEB 2015

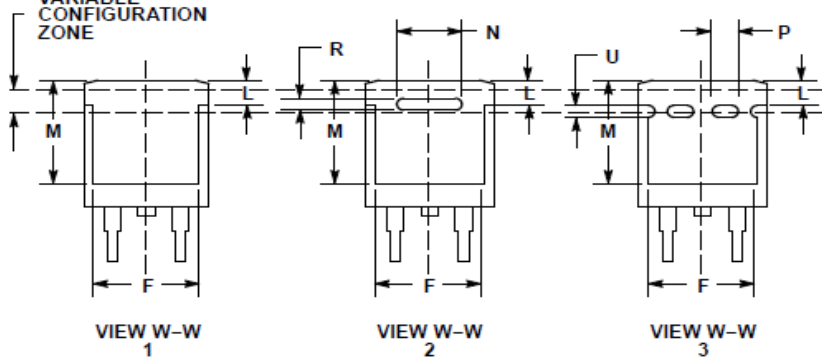


NOTES:

1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.
3. 418B-01 THRU 418B-03 OBSOLETE, NEW STANDARD 418B-04.

DIM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.340	0.380	8.64	9.65
B	0.380	0.405	9.65	10.29
C	0.160	0.190	4.06	4.83
D	0.020	0.035	0.51	0.89
E	0.045	0.055	1.14	1.40
F	0.310	0.350	7.87	8.89
G	0.100 BSC		2.54 BSC	
H	0.080	0.110	2.03	2.79
J	0.018	0.025	0.46	0.64
K	0.090	0.110	2.29	2.79
L	0.052	0.072	1.32	1.83
M	0.280	0.320	7.11	8.13
N	0.197 REF		5.00 REF	
P	0.079 REF		2.00 REF	
R	0.039 REF		0.99 REF	
S	0.575	0.625	14.60	15.88
V	0.045	0.055	1.14	1.40

VARIABLE CONFIGURATION ZONE



影響を受ける部品の一覧:

BUB323ZG	MBRB2515LT4G	MBRB60H100CTT4G	MURB1660CTG	NTB5605PT4G	NTSB30U100CTG
BUB323ZT4G	MBRB2515LT4H	MBRB8H100T4G	MURB1660CTT4G	NTB60N06T4	NTSB30U100CTT4G
MBRB1045G	MBRB2535CTLG	MJB41CG	MURHB840CTG	NTB60N06T4G	NTSB40100CTG
MBRB1045T4G	MBRB2535CTLT4G	MJB41CT4G	MURHB840CTT4G	NTB6410ANT4G	NTSB40100CTT4G
MBRB1545CTG	MBRB2545CTG	MJB42CT4G	MURHB860CTT4G	NTB6413ANT4G	NTSB40120CTG
MBRB1545CTT4G	MBRB2545CTT4G	MJB44H11G	NGB8202ANT4G	NTSB20100CTG	NTSB40120CTT4G
MBRB1645T4G	MBRB3030CTG	MJB44H11T4G	NGB8206ANSL3G	NTSB20100CTT4G	NTSB40200CTG
MBRB20100CTG	MBRB3030CTLG	MJB45H11G	NGB8206ANT4G	NTSB20120CTG	NTSB40200CTT4G
MBRB20100CTT4G	MBRB3030CTT4G	MJB45H11T4G	NGB8206ANTF4G	NTSB20120CTT4G	NTSB60100CTG
MBRB20200CTG	MBRB30H60CTT4G	MJB5742T4G	NTB25P06T4G	NTSB20U100CTG	NTSB60100CTT4G
MBRB20200CTT4G	MBRB40250TG	MTB50P03HDLT4G	NTB35N15T4G	NTSB20U100CTT4G	XMBRB1045T4G
MBRB2060CTG	MBRB40250TT4G	MURB1620CTG	NTB45N06LT4G		NTSB30100CTG
MBRB2060CTT4G	MBRB4030G	MURB1620CTRG	NTB45N06T4G		NTSB30100CTT4G
MBRB20H100CTT4G	MBRB4030T4G	MURB1620CTRT4G	NTB52N10T4		NTSB30120CTG
MBRB2515LG	MBRB41H100CTT4G	MURB1620CTT4G	NTB5405NT4G		NTSB30120CTT4G